

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
PUBLIC RELATIONS DIVISION
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8310 (Japón)

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

N.º 3186

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Consultas de los clientes

Power Device Overseas Marketing Dept. A and Dept. B
Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/

Consultas de los medios

Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation
prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp

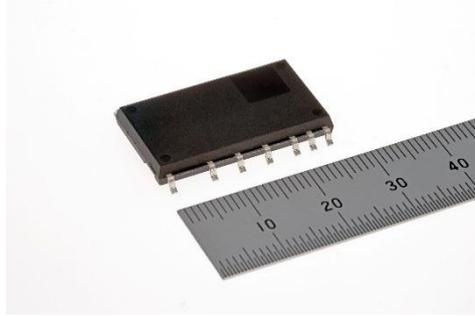
www.MitsubishiElectric.com/news/

Mitsubishi Electric lanza el IPM de paquete de montaje en superficie MISOP

Descubra que los sistemas de inversores pueden ser más pequeños de tamaño, más sencillos de gestionar y más fáciles de instalar

TOKIO, 16 de abril de 2018– [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que lanzará un módulo de alimentación inteligente (IPM, del inglés "intelligent power module") de paquete de montaje en superficie MISOP™ (módulo de alimentación de salida pequeño inteligente Mitsubishi Electric, del inglés "Mitsubishi Electric Intelligent Small Outline Power Module") que facilitará la implementación de sistemas de inversores de bajo coste, gracias a su diseño de paquete compacto y de soldadura fácil. Con un diseño bien organizado, IC de controlador integrados y circuitos de protección, se prevé que el nuevo MISOP lidere el mercado de sistemas de inversores con placas de circuito impreso (PCB, del inglés "printed circuit board") con un diseño más pequeño y sencillo. Además, el montaje de las PCB mediante soldadura por refusión permitirá un montaje más sencillo y rentable en comparación con los productos que requieren un montaje de orificio pasante. Se lanzará el 1 de septiembre.

El nuevo MISOP de Mitsubishi Electric se exhibirá en las ferias comerciales más importantes, que incluyen MOTOR TECH JAPAN 2018 durante la TECHNO-FRONTIER 2018 en Makuahari, Japón, del 18 al 20 de abril, PCIM Europe 2018 en Núremberg, Alemania, del 5 al 7 de junio, y PCIM Asia 2018 en Shanghái, China, del 26 al 28 de junio.



IPM de paquete de montaje en superficie MISOP

En consonancia con el aumento de las medidas mundiales relacionadas con la protección del medio ambiente y el ahorro de energía, los sistemas de inversores incluso se están incorporando a los pequeños motores de ventiladores, incluidas las unidades interiores y exteriores de los sistemas de aire acondicionado. El nuevo IPM de paquete de montaje en superficie MISOP de Mitsubishi Electric está diseñado para estos sistemas de inversores, que deben utilizar módulos semiconductores de baja potencia y ser fáciles de montar.

Características del producto

1) Diseño simplificado para sistemas de inversores

- El IPM de paquete de montaje en superficie permite la soldadura por refusión
- Tamaño pequeño en PCB

2) Ayuda a reducir el tamaño de los sistemas de inversores y simplificarlos

- Módulo IGBT de dirección inversa (semiconductor de alimentación con módulo IGBT y diodo en un chip) con la estructura de capa fina de séptima generación permite el uso de chips IGBT más pequeños y menos espacio entre los chips.
- Menos componentes externos gracias a los IC de controlador de puerta incorporados con funciones de protección y diodo cebador integrado (BSD*) con resistencia de estabilización.
- Diseño de terminal optimizado que permite PCB de diseño sencillo y sistemas de inversores pequeños.

*Diodo de alta tensión que se utiliza en el circuito de la bomba de carga para obtener varias fuentes de alimentación a partir de una sola fuente de tensión

3) Funciones de protección para diseños de sistemas de inversores más flexibles.

- Protección contra sobrecalentamiento y señal analógica para la supervisión de la temperatura de control del IC.
- Protección contra cortocircuitos mediante resistencia de derivación externa y función de enclavamiento de entrada de PWM que permiten diseños de circuitos de protección flexibles.

Programa de ventas

Producto	Modelo	Tensión	Corriente	Envíos
Serie MISOP de montaje en superficie	SP1SK	600V	1A	1 de septiembre
	SP3SK		3A	

Especificaciones principales

Modelo	SP1SK	SP3SK
Tensión	600V	
Corriente	1A	3A
Dimensiones	15,2 × 27,4 × 3,3 mm	
Chips integrados	Puente inversor trifásico con chips RC-IGBT (IGBT+FWD), HVIC, LVIC y BSD integrados	
Funciones integradas	<ul style="list-style-type: none">- Protección contra cortocircuitos mediante resistencia de derivación externa- Protección frente al suministro de potencia de baja tensión- Protección de salida de Fo en el polo negativo- Protección contra sobrecalentamiento- Salida de voltaje de temperatura análoga- Enclavamiento	
Otros	Inversor con polo negativo de emisor dividido (3 derivaciones)	
Aplicaciones	Motores de soplador, bombas de agua y lavaplatos	

Conciencia medioambiental

Los productos mencionados en este comunicado cumplen con la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS en inglés).

###

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con más de 90 años de experiencia en la provisión de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las comunicaciones, en el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrónicos de consumo, en la tecnología industrial, en la energía, en el transporte y en los equipos de construcción. Aprovechando el espíritu de su declaración corporativa "Changes for the Better" y su declaración medioambiental "Eco Changes", Mitsubishi Electric se esfuerza por ser una empresa internacional comprometida con el medio ambiente líder y por enriquecer la sociedad con la tecnología. La empresa registró ventas de grupo consolidadas de 4 238 600 millones de yenes (unos 37 800 millones de dólares estadounidenses*) en el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2017. Para obtener más información, visite: www.MitsubishiElectric.com

*Tipo de cambio de 112 yenes por dólar estadounidense, tipo concedido por el Mercado de divisas de Tokio el 31 de marzo de 2017

MISOP es una marca registrada de Mitsubishi Electric Corporation